

第2次「tokチャレンジ21」

2005年3月期を踏まえた今後の方針

2005年5月19日

第2次中期計画の重点課題と取組み状況

- 微細加工技術の「水平的展開」の充実・拡大
 - CFPR（樹脂ブラック）、実装/パッケージ材料の展開
 - 新規分野・用途の開拓、新規プロセス・製品の研究・開発を遂行
「NEEDS」「SEEDS」の探索 「開発企画室」と「営業開発室」
- 微細加工技術の「垂直的展開」の加速・充実
 - 新規微細加工プロセスの提案、ソリューション・ビジネスの展開
 - シュリンクプロセスによる“一世代先の微細加工技術”の提案
 - 液浸露光技術における、“高解像・高信頼プロセス”の提案
- コラボレーションの効果的な活用
 - スピード・コスト・リスクの諸観点からのベスト・セレクション
 - 多方面で共同研究開発・実験の実施
- tok独自研究の強化
 - R（研究）とD（開発）のバランス最適化による製品開発力強化
現在、最先端半導体製造用材料の研究開発棟を建設中

第2次中期計画進捗状況のポイント

■電子材料

- KrFレジスト : 新プロセス移行期における新規需要獲得の進展
一方、「採用～量産投入」タイムラグが顕著化
- ArFレジスト : 65nmノード以降の微細加工技術の開発進展
短期的には既存開発製品の量産適用の遅れによる影響

■液晶材料・PDPパッケージング材料

- TFTレジスト : ユーザーニーズの把握とマーケティング活動進展
- CFPR : 環境対応で、樹脂ブラックの需要が急増、生産能力も倍増
- PDP材料 : Pbフリー材料へ対応、誘電体材料など積極的な新製品開発
但し、PDP-TVの伸びが想定を下回る

■印刷化材

- 価格競争は依然激しいが、コスト削減を推進中

■装置事業

- 市場ニーズ・動向の把握
- 装置立ち上げ作業の効率化・短期化に取り組中

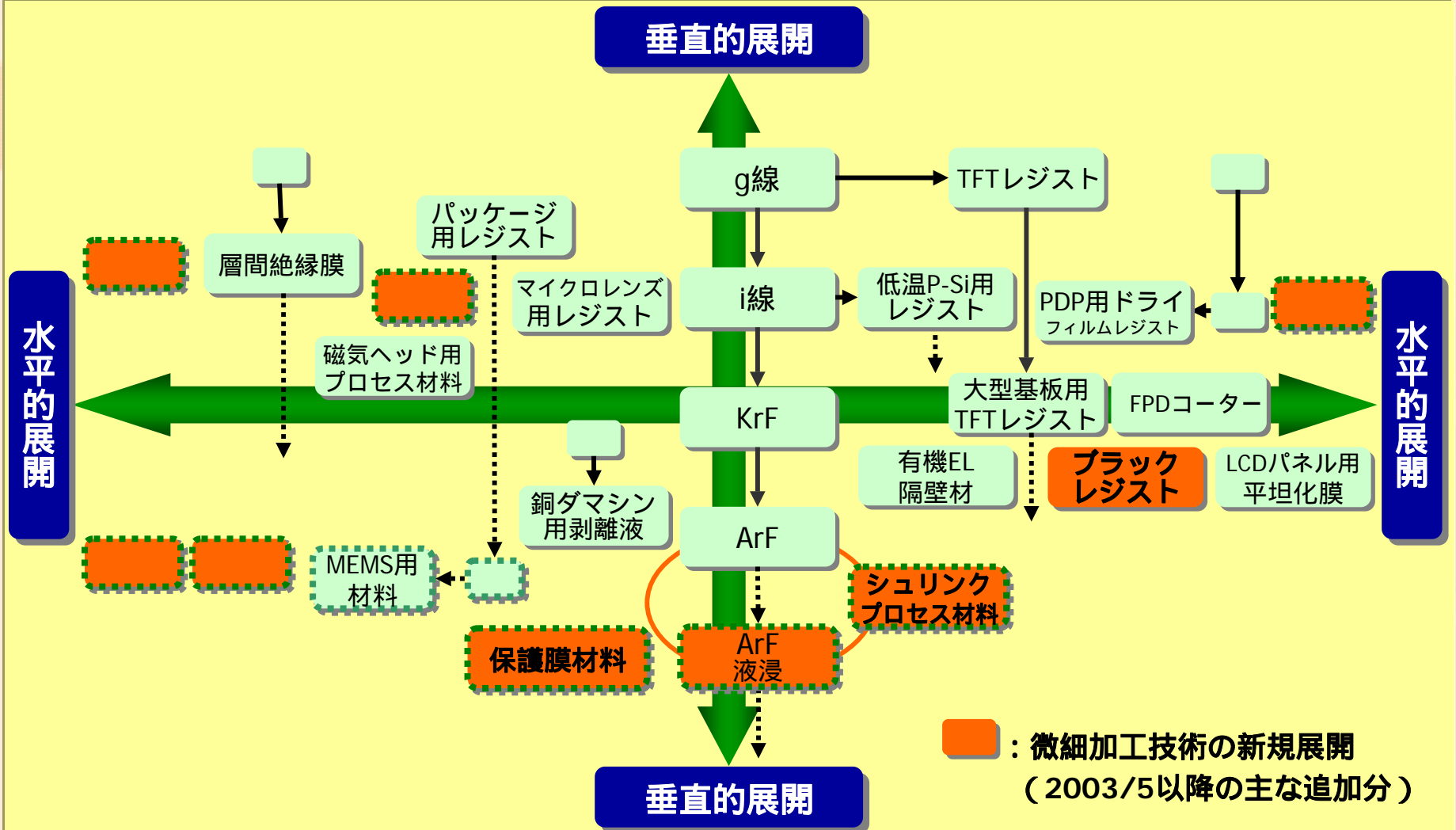
収益目標に対する進捗状況（連結）

（百万円）

	2006/3 中計目標	2004/3 実績	2005/3 実績	2006/3 予想
売上高	93,800	83,121	88,960	93,300
電子材料	46,300	40,053	41,213	43,800
液晶材料	14,300	13,083	16,740	20,000
PDPパッケージング材料	10,200	7,670	7,486	7,500
印刷化材	8,200	6,162	6,214	5,300
装置	14,800	16,165	17,305	16,700
営業利益	9,100	5,703	7,295	8,650
経常利益 （経常利益率）	9,200 （9.8%）	6,036 （7.2%）	8,051 （9.1%）	8,800 （9.4%）
当期純利益	5,000	4,751	5,088	5,300
海外売上比率	58%	53%	57%	57%

微細加工技術の多角的展開の強化

垂直・水平両面で積極的な研究・開発に着手・進行中



65nm ノード以降のリソ技術に関する提案

液浸露光

偏光露光

超高開口
係数

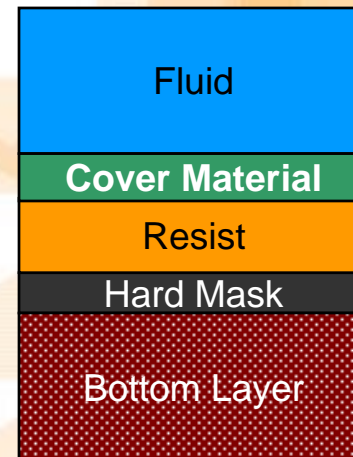
液浸媒体との相互作用・反射率制御・屈折制御

物理的限界

パターン倒壊等

実用的な多層イメージングを想定・4 (+1) 種類の材料開発を推進
リソグラフィー技術のソリューションを提供

- ◇ 保護膜材料
- ◇ 液浸レジスト
- ◇ 下地反射防止膜
- ◇ 塗布型ハードマスク
- ◇ 下層材料



今後の方針

- 「ブランド力」の構築
- 半導体製造分野は微細加工技術のフラッグシップ先頭を走り続ける、必要な経営資源は投入最先端の開発と品質管理
- 事業リスク等のマネジメントをより一層重視
 - 技術の「水平的」展開によるリスクの分散化
 - オペレーション体制の最適化によるリスクの抑制・低減
 - R&D推進体制の最適化による開発リスクの抑制・低減

<http://www.tok.co.jp/>

（ご注意）

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。